附件1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **培训课程大纲（2023）** | | | |
| 时间 | 主要内容 | 学时 | 授课老师 |
| 第1天 | 1、电路板电路设计中常见到的DFM问题及解决措施 2、元器件的选择 3、SMD（贴装元器件）焊盘设计 4、现场答疑 | 7 | 冯俊谊 |
| 第2天 | 1、DIP插装元器件焊盘封装设计 2、焊盘与印制导线连接的设计 3、测试点设计 4、波峰焊贴片元件的排列方向设计--红胶工艺设计 5、拼版设计与拼接方式—V-CUT设计等 6、布线设计 7、阻焊和丝印的设计 8、元器件之间的布局设计  9、散热设计 10、现场答疑 | 7 |
| 第3天 | 1、机箱元器件布局和装配可靠性设计要求  2、可制造性设计---降低生产成本提高效率设计 3、 Mark (基准标志)设计 4、选择元器件封装及包装形式 5、电路板设计的输出文件 6、结构的设计—简单好装配 7、如何建立和设定公司统一的DFM标准化封装库和DFM标准化体系 8、落实DFM设计的措施 9、 DFM审核报告  10、现场答疑 | 7 |

**注：以上内容及顺序可能会根据情况略有调整，以讲师实际授课安排为准。**

**【讲师介绍】**

讲师冯俊谊，现任：张家口富祥科技有限公司董事长兼技术总监、北京康斯特仪表科技股份有限公司DFM专家顾问。对DFM专业设计有20多年实战经验，申请了三项DFM相关发明专利，十二项实用新型专利。作为专家顾问向多家上市公司、行业领军企业的研发团队分享了DFM设计和实战经验。冯老师从产品的品质和成本都是设计出来的理念出发，不断攻克疑难问题，通过DFM实战经验的分享，提升国内电子产品在国际上的竞争力。

历任世界500强企业伟创力、Motorola、海湾集团（消防行业龙头企业--上市公司）等大型外资企业资深高级工程师、DFM技术总监、制造总监、总工程师等，在美国和新加坡被授予UNIVERSAL和SIEMENS高级工程师。

曾多年在外企和行业领军企业钻研学习DFM的专业知识和实战成果。

曾在英国学习安防领域最高级别的国际化LPCB质量管理体系认证，并被授予鉴定资格证书。清华大学伟创力联合实验室获DFM高级研修专业设计高级研修证书。

曾于Motorola、日本松下和丰田公司针对“六西格玛”质量管理策略、企业精益化生产管理深造学习。